KAYOU
Accelerating progress through technology !

市场调研报告

華陽株式会社
SiC产业报告

2026年上半年

全球趋势与中国市场结构变化



華陽株式会社

目录

专题·调研概述·国际动态·中国SiC产业结构

01 专题 005–008

- 10条重要新闻综览 006
- 重要新闻详解 007–008

02 调研概述 009–014

- 经营与销售重点议题 010
- 供给、需求与价格监测指标 011
- 上半年变化与下半年关注事项 012
- 价值链及企业业务范围 013
- 覆盖期间、地区与数据口径 014

03 国际动态 015–021

- 全球市场增长情景 2020–2035 016
- 分应用需求与分地区生产 017
- 欧洲、北美、日本与中国市场动态 018–021

04 中国SiC产业结构 022–028

- 从材料到终端应用的企业与角色 023
- 独立材料商、IDM与代工交易结构 024
- 国内供应、进口与海外生产 025
- 销售、生产与出货变化 026
- 库存、产能利用率、价格及上半年总结 027–028

章节标题及小标题所列页码与本报告连续页码对应。

目录

SiC衬底·SiC外延片

05 SiC衬底 029–055

季度产能变化与8英寸化 030
各厂商产能布局及测算方法 031–032
出货口径及按尺寸/企业的出货量测算 033–036
出货结构、产能利用率与一致性校验 037–039
期后更新：交期与价格跟踪 040
价格参考序列及厂商信息 041–042
价格形成机制与采购预算区间 043–044
6/8英寸采购对比 045
价格情景：2026年末至2030年 046
中国市场的合作、投资与融资 047–050
SST、先进封装与车规级技术展望 051–055

06 SiC外延片 056–070

中国季度产能变化 057
全球商业化供应产能份额 058
各企业6/8英寸有效产能 059
产能与利用率对比及季度变化 060–061
各企业供应结构与产能利用率变化 062–063
出货量与内部供应量情景测算 064
采购预算与价格变化 065–066
中国/海外销售区域结构 067
芯片成本与外延片的作用 068
国际合作与扩大销售的条件 069–070

章节标题及小标题所列页码与本报告连续页码对应。

目录

SiC功率器件·SiC功率模块·应用

07 SiC功率器件 071–094

中国量产供应与车规级采购挑战 072–073
国产化进程与海外企业机会 074
中资企业全球份额与产量情景 075–076
6/8英寸晶圆厂产能布局 077–081
产业结构、利用率与出货测算 082–084
各应用需求及2026—2027年展望 085–086
各企业晶圆投片量与应用结构 087–089
新需求：AIDC与汽车对比 090–091
沟槽型与超级结技术 092
MOSFET/SBD价格及年末预测 093–094

08 SiC功率模块 095–107

IGBT/SiC配置与中国国产化 096–097
各厂商装机量与市场结构 098–099
主要OEM的模块/芯片供应 100–101
价格、成本、收益结构与毛利率 102–104
中国投资合作及海外龙头动态 105–107

09 应用 108–124

整体需求、技术与电压路线图 109–110
中国NEV销量、渗透率与高压化 111–113
小米、ZEEKR、BYD车型案例 114–116
光伏、储能、风电与输电 117–118
AIDC电力成本、需求与新技术 119–121
家电与工业电源应用及进入机会 122–123
先进封装散热与AR光学材料 124

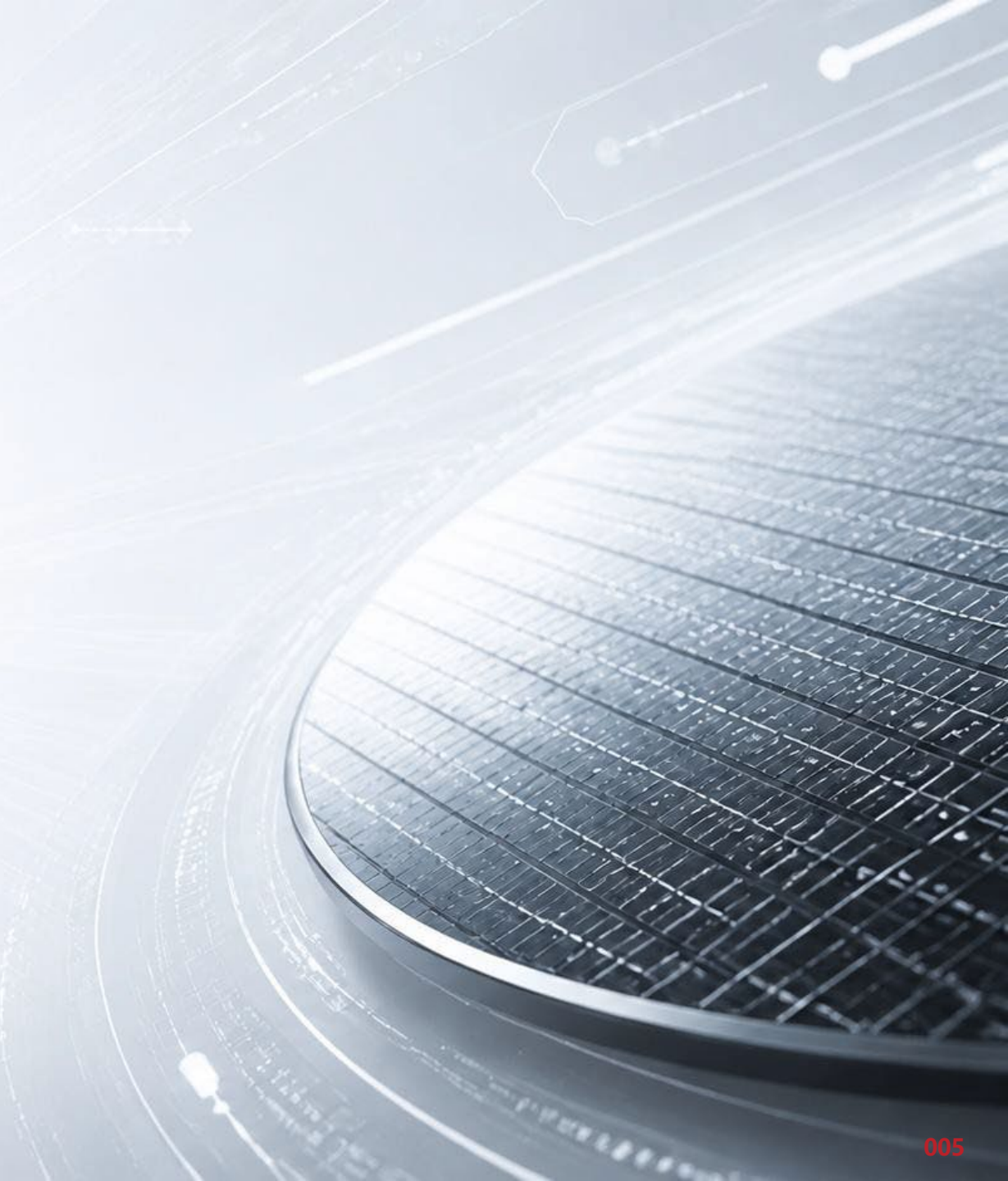
章节标题及小标题所列页码与本报告连续页码对应。

KAYOU
Accelerating progress through technology !

专题

華陽 SiC产业报告

2026年上半年



2026年上半年，SiC产业十大重要新闻

基于已确认事实，梳理材料、量产体系、产品及需求端的变化

01 东芝、ROHM、三菱电机推进业务整合磋商

03.27 已签署半导体与功率器件业务MoU，整合条件与细节尚未确定。

02 ST启动意中200 mm SiC生产

第二季度 卡塔尼亚与重庆开始生产。7月发布的资料确认已在上半年实施。

03 博世将德国SiC生产转向200 mm

5月 罗伊特林根停止150 mm SiC生产，全面转向200 mm。

04 Wolfspeed发布300 mm单晶SiC

01.13 宣布成功制备单晶晶圆，但并非300 mm商业化量产公告。

05 ROHM开发第五代SiC MOSFET

3月 3月完成开发、4月公布；称175℃下导通电阻降低约30%。

06 吉利与安森美扩大900 V车型合作

04.28 宣布在基于SEA-S的SEP系统中导入EliteSiC技术。

07 英飞凌就SiC-SST达成合作

03.24 为DG Matrix的Interport供应SiC，面向AI电源基础设施。

08 Wolfspeed实现10 kV SiC商业化

03.05 发布10 kV耐压功率MOSFET，面向中压电源、SST等应用。

09 天域半导体赴港上市并投资外延产能

03.30 净募集资金约15.6亿港元，计划将71%用于扩大外延产能。

10 天科合达与青禾合作开发键合SiC衬底

01.16 合作涵盖8英寸键合SiC及12英寸以上复合散热衬底。

范围：2026年1—6月；核验截止：2026.10.30；華陽遴选（不分先后）；数据与规划据公司公开信息。

KAYOU
Accelerating progress through technology !

联系我们

中国SiC市场信息、采购及业务合作咨询

華陽株式会社

代表董事兼总经理、CEO
陈 舒卡 / Chin Yutaka / 陳　ユタカ

E-mail　chin.yutaka@kayou.co.jp

Web　www.kayou.co.jp

TEL（日本）　+81 90-8321-0916

TEL（中国）　+86 177-1553-0321

下期预告

華陽 SiC产业报告
2026年第三季度版
计划于2027年2月发布

产品与服务

查看产品信息